立创商城
WWW.SZLCSC.COM





基础参数

名称：K-5202 导热硅胶

规格：80g/支

适用范围：最主要的应用是代替导热硅脂（膏）作CPU与散热器、晶闸管智能控制模块与散热器、大功率电器模块与散热器之间的填充粘接。用此胶后可以除掉传统的用卡片和螺钉的连接方式，带来的结果是更可靠的填充散热、更简单的工艺、更经济的成本。 有效期：12个月

立创商城
WWW.SZLCSC.COM

技术参数

项目	
外　　观	灰色
粘度（cp）	膏状
密度（g/cm3）	1.60
表干时间（25℃，min）	≤30
抗拉强度(MPa)	≥2.5
扯断伸长率（%）	≥100
剪切强度（MPa）	≥1.5
硬度(shore A)	45～55
使用温度范围（℃）	-60～280
介电强度（kV/mm）	≥20
介电常数（@60Hz）	2.8
体积电阻（Ω.cm）	1×10^{15}
导热系数（w/(m.k)）	0.80